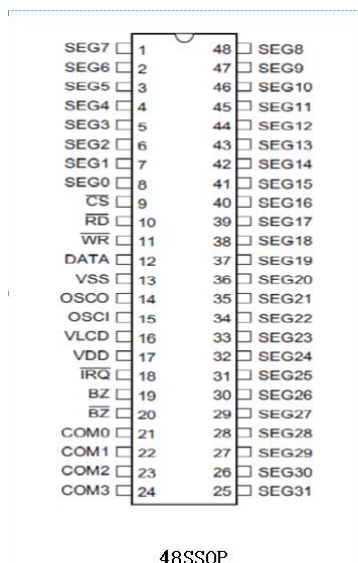


LCD 控制驱动电路

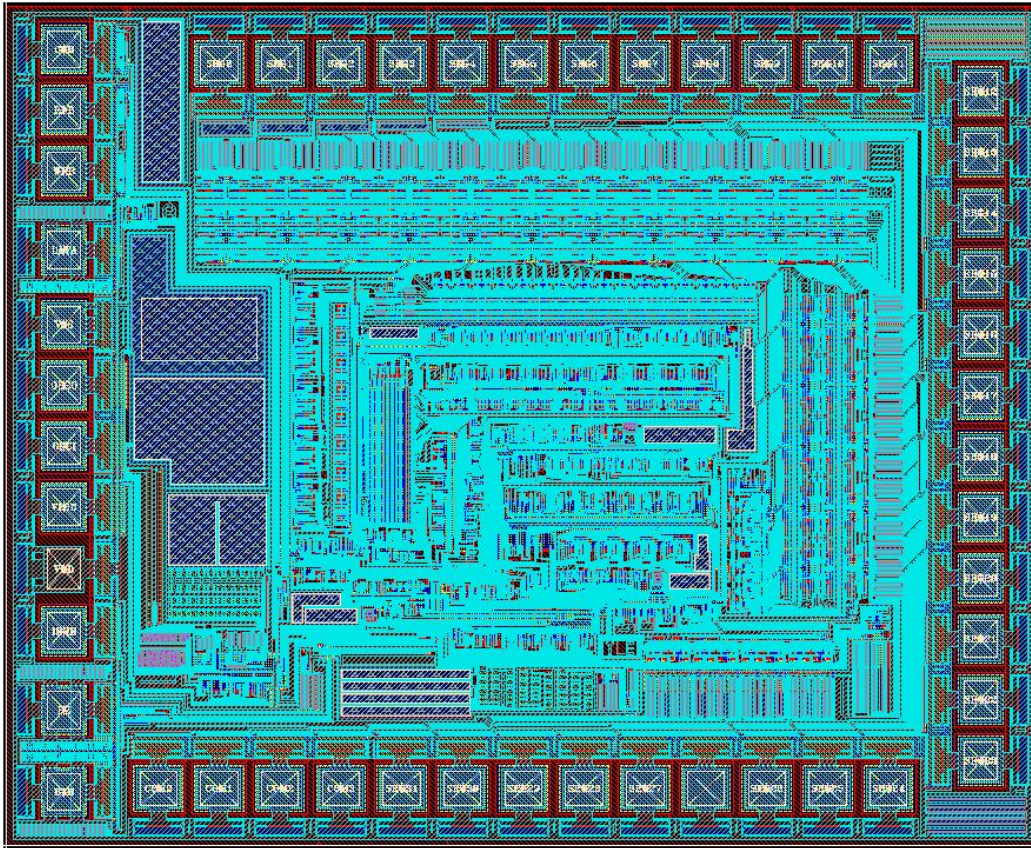
1、芯片信息

序号	项 目	内 容	备注
1	产品名称	YM1621B	E002C
2	封装形式	SSOP48	
3	PAD 数目	49	
4	打线数目	48	
5	芯片衬底电位	VDD	导电胶
6	圆片尺寸	6'	
7	芯片面积(不含划片槽)	1560um*1270um	划片槽(80um)
8	PAD 尺寸(um)	50*56	下面无图形
9	铝垫厚度(um)	1	铝垫尺寸(70um)
10	金丝直径(um)	20um	钼铜线
11	单片理论管芯数	6800	
12	最大功耗 (mw)	1000	
13	最高工作频率 (HZ)	500k	
14	工作环境温度 (°C)	-40~85	
15	对外壳的其它特殊要求		
16	成品表面标识		

2：封装脚位图

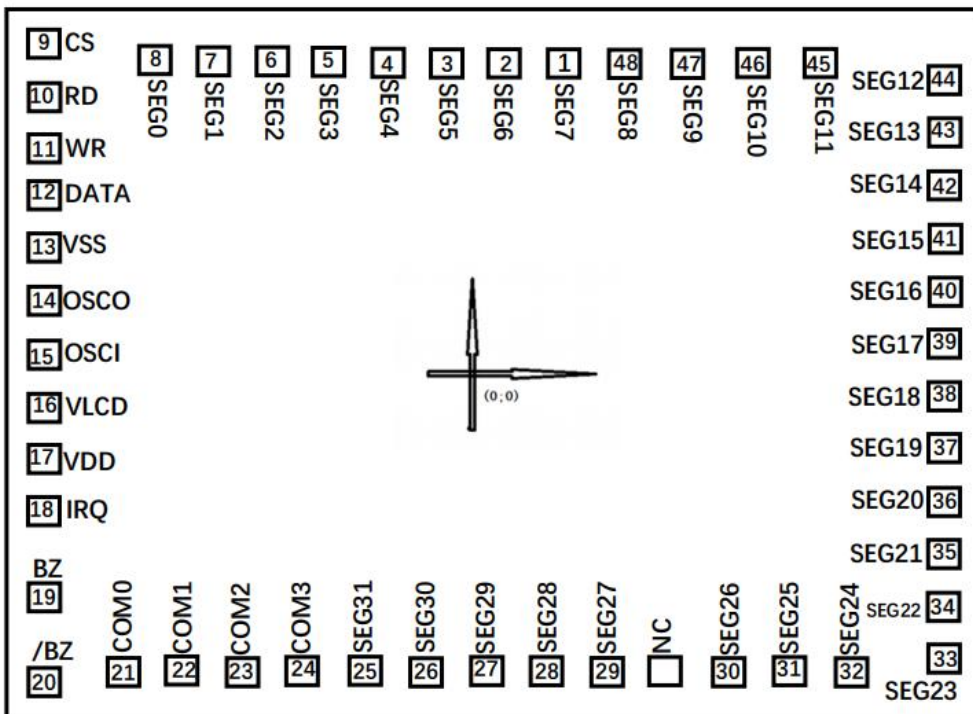


### 3: 概貌图



CHIPSZIE: 1560um\*1270um

### 4: Pad 图



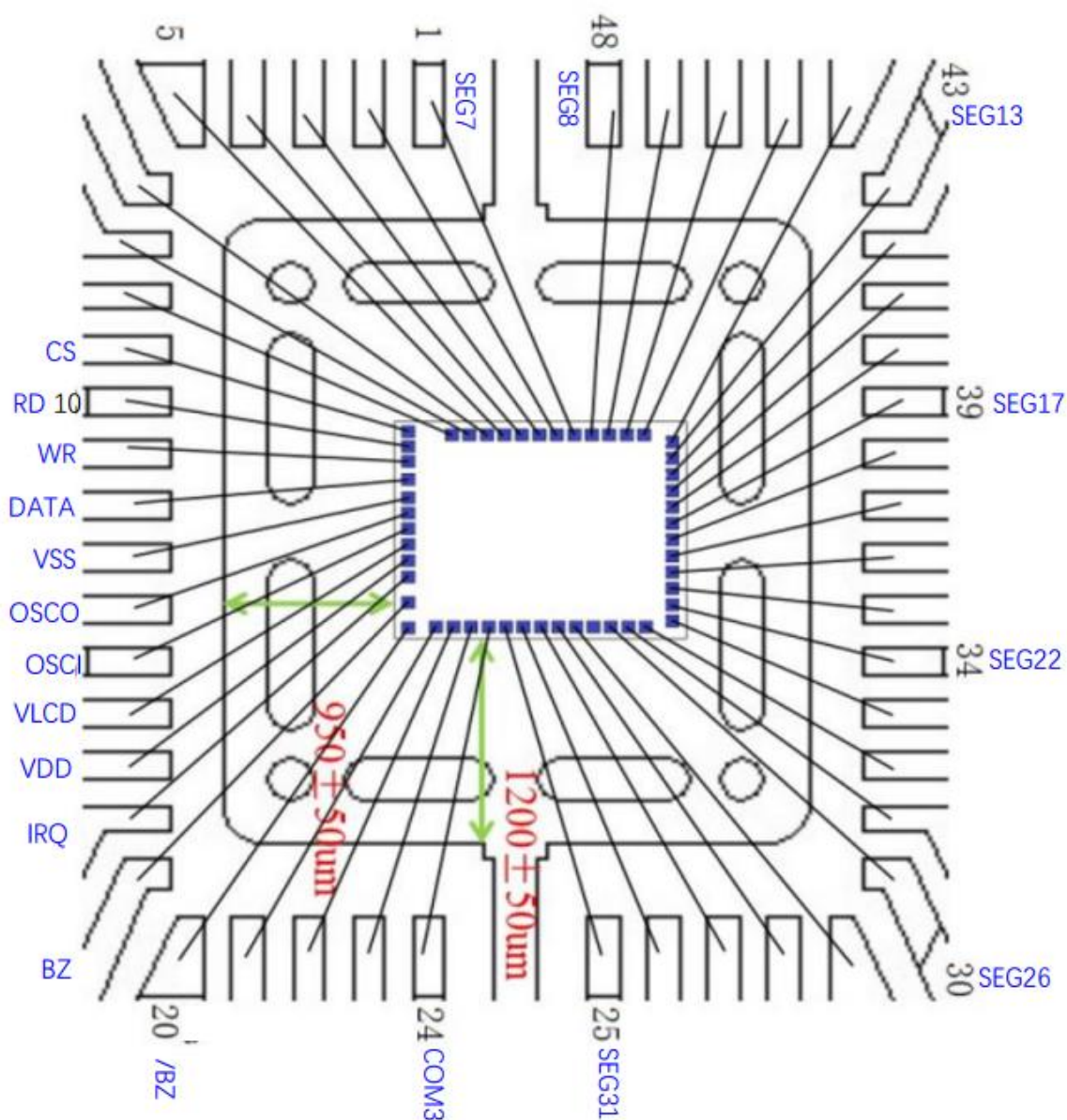
## 5、芯片压焊点坐标

芯片中心点坐标：     (0,0)     (要求为 0,0)

Pad Pin	X(um)	Y(um)	Pad Pin	X(um)	Y(um)
CSB	-692.7	569.4	SEG23	692.8	-506
RDB	-692.7	477.4	SEG22	692.8	-414
WRB	-692.7	385.4	SEG21	692.8	-322
DATA	-692.7	265.8	SEG20	692.8	-230
VSS	-692.7	153.4	SEG19	692.8	-138
OSCO	-692.7	61.4	SEG18	692.8	-46
OSCI	-692.7	-30.6	SEG17	692.8	46
VLCD	-692.7	-122.6	SEG16	692.8	138
VDD	-692.7	-216.3	SEG15	692.8	230
IRQB	-692.7	-310	SEG14	692.8	322
BZ	-692.7	-429.6	SEG13	692.8	414
BZB	-692.7	-553.6	SEG12	692.8	506
COM0	-550.3	-548	SEG11	553.7	548
COM1	-458.3	-548	SEG10	461.7	548
COM2	-366.3	-548	SEG9	369.7	548
COM3	-274.3	-548	SEG8	277.7	548
SEG31	-182.3	-548	SEG7	185.7	548
SEG30	-90.3	-548	SEG6	93.7	548
SEG29	1.7	-548	SEG5	1.7	548
SEG28	93.7	-548	SEG4	-90.3	548
SEG27	185.7	-548	SEG3	-182.3	548
SEG28 (NC)	277.7	-548	SEG2	-274.3	548
SEG26	369.7	-548	SEG1	-366.3	548
SEG25	461.7	-548	SEG0	-458.3	548
SEG24	553.7	-548			



6: 打线示意图



云普芯片技术（深圳）有限公司  
深圳市云普电子科技有限公司

电话：0755-83985848

技术：18028702018

网址：WWW.YM-IC.COM

深圳市福田区彩田路2010号中深花园大厦B座2609